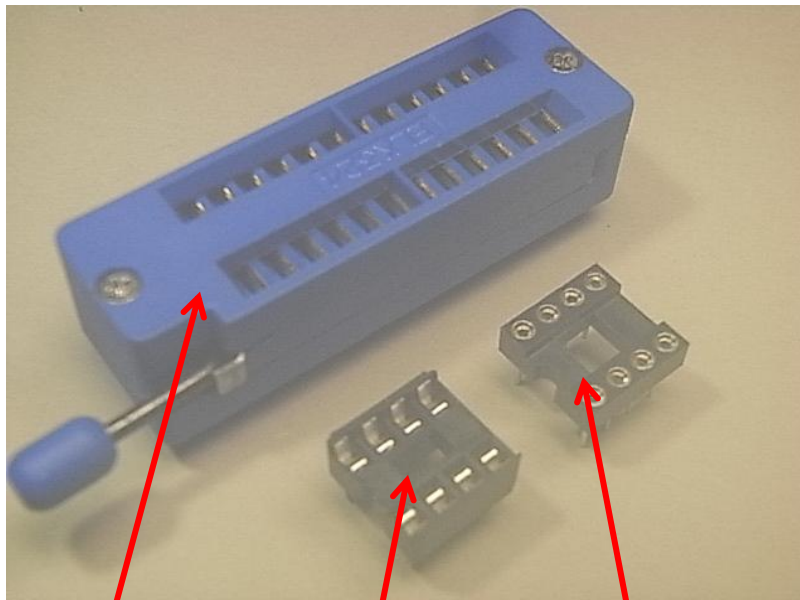


ICソケットの接触方式

ICソケットのコンタクト(接触部)の方式として、「**板バネ式**」、「**丸ピン式**」
「**ゼロプレッシャー**」などがあり、写真1に外観例を示します。

写真1 ICソケット外観



ゼロプレッシャーソケット

板バネ式ソケット

丸ピン式ソケット

★板バネ式と丸ピン式

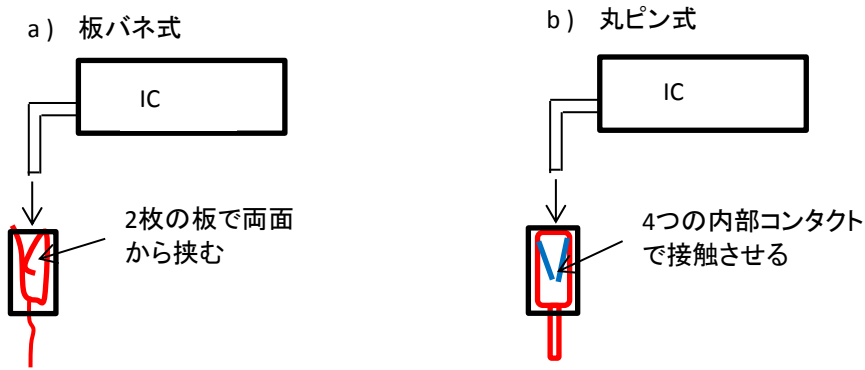
板バネ式は図1 a)のように部品のリードを2枚の板で両側から挟む方式です。

丸ピン式は写真1のように形状が丸ですが、図1 b)のように4つの内部コンタクトで接触させる方式です。

板バネ式は「面」で接触しますが、丸ピン式は4点で接触させる為、**保持性が良く、振動、衝撃に対して有利です。**

挿抜耐久(部品の抜き差し)は丸ピン式の場合、コンタクトの材質によりますが、20~100回ほどです。

図1 コンタクト(接触)の違い

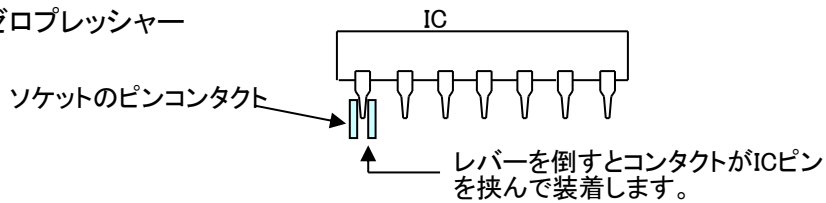


★ゼロプレッシャーソケット

ゼロプレッシャーICソケットはIC用ソケットの種類の一つで、ICが簡単に着脱できる構造になっています。ZIFソケット(Zero Insertion Force Socket)とも言います。力をかけずにICの着脱が出来、ソケットに着脱用のレバーが付いていて、このレバーを倒すとICが固定され、レバーを起こすとICのピンがフリーになります。

ICのテストや、ROMライターなどのIC抜き差しが多い場合に使用します。挿抜耐久は写真1の製品(Linkman ELK324)の場合、25000~50000回です。

図2 ゼロプレッシャー



ゼロプレッシャーソケットを基板へはんだ付けする時は図3のようにレバーを起こした状態(コンタクトはオープン)で行います。

レバーを倒した状態(コンタクトはクローズ)ではんだ付けすると接触不良の原因になります。

図3 ゼロプレッシャーソケットのはんだ付け

